

| PCB 焊接 工艺要求 | 产品名称 | 产品型号 | 工序 | 文件编号 | 版本 | 页数 | 制订时间 |
|----------------|------|----------------------------|----|---------------|------|-----|----------|
| | 直流伺服 | MGRD-2408(12)SMAO_POW_V2.1 | 焊接 | QM03320090801 | V2.1 | 1/2 | 20200908 |

1. MGRD-2408(12) SMAO_POW_V2 加锡位置

顶层

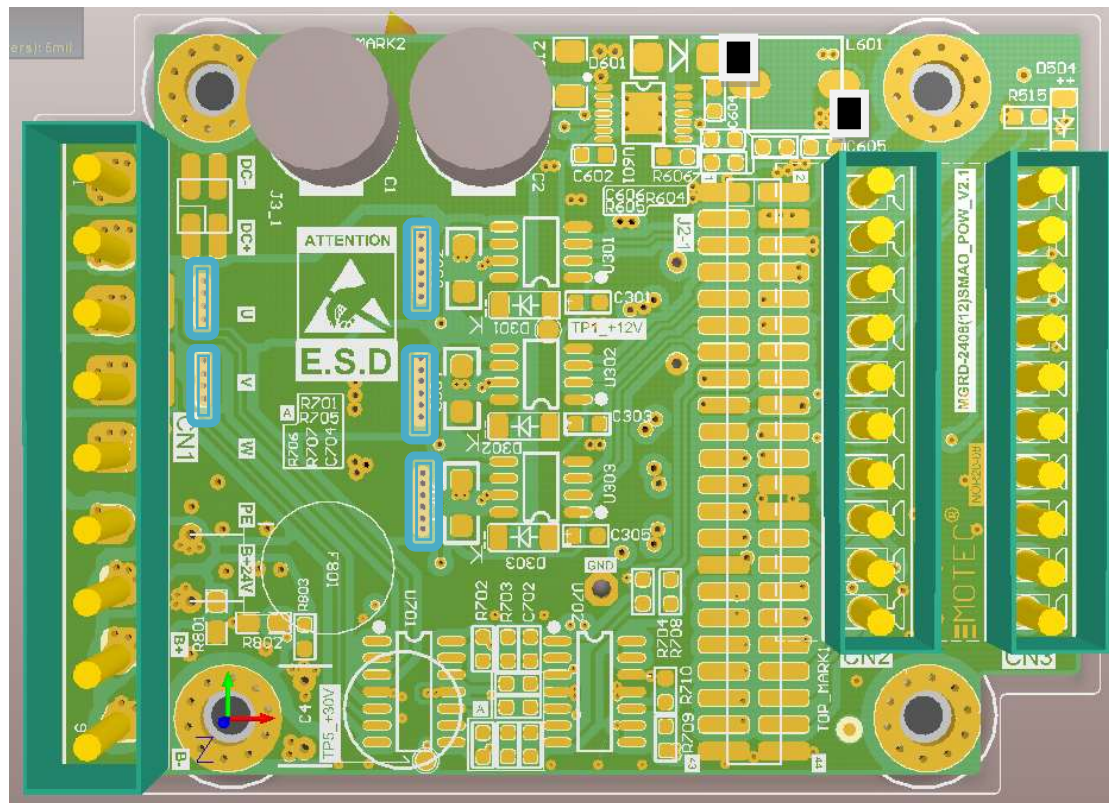


图 1

蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔内从顶层至底层注满焊锡；

底层

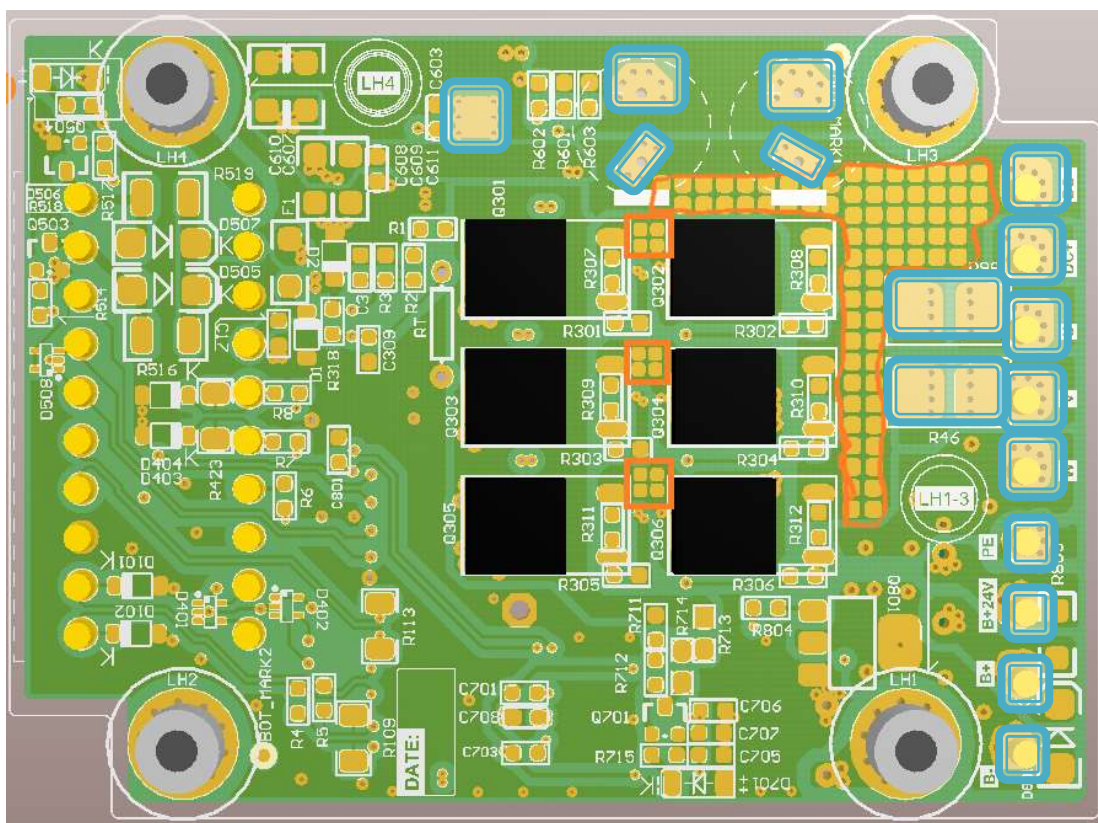


图 2

1) 橙色框内 PAD 加锡，加锡厚度为 0.2mm；

2) 蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔内从底层至顶层注满焊锡；

| | | | | | | | |
|----------------|------|----------------------------|----|---------------|------|-----|----------|
| PCB 焊接 工艺要求 | 产品名称 | 产品型号 | 工序 | 文件编号 | 版本 | 页数 | 制订时间 |
| | 直流伺服 | MGRD-2408(12)SMAO_POW_V2.1 | 焊接 | QM03320090801 | V2.1 | 2/2 | 20200908 |

2. 焊接基本要求

- 1) 功率管 Q301~Q306 共计 6 个 (T0-252 封装的管子)，紧贴线路板焊接；禁止浮高；
- 2) 温感热敏电阻 RT 紧贴 PCB 的下表面焊接 (见图 3)；
- 3) A) 注意区分贴片螺母的型号，其中 LH4 位置焊接贴片螺母 SMTS03040MTS，LH1~LH3 位置焊接 SMTWE3340MTS (无螺纹中通支撑柱)

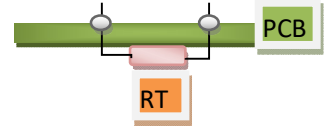




图 3

贴片螺母规格区分

A) SMTWE3340MTS (绿色字符为高度：40 为 4mm 高) 

B) SMTS03040MTS (蓝色字符为高度：040 为 4mm 高) 

B)所有贴片螺母的焊接均须垂直于主板落到底焊接，严禁歪斜；

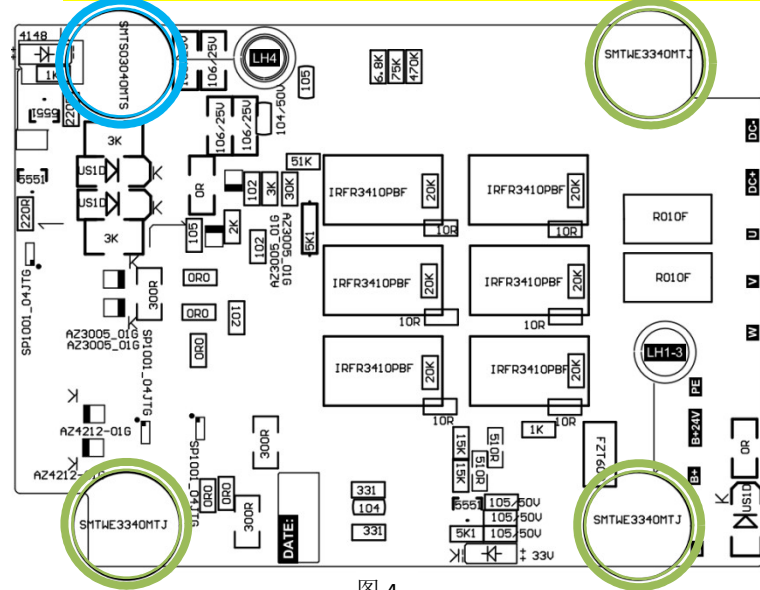


图 4

- 4) 排针居中，对齐中心位置焊接，XY 方向偏差小于 0.3mm，严禁浮高现象；
- 5) 所有端口插座焊接需要压到底焊接，不容许歪扭，偏差要小于 0.3mm；
- 6) 顶层电感 L601，按照图 1 的黑色区域，涂覆 704 黑色胶，粘接与线路板，胶的厚度要高于 1mm，不要拉丝；
- 7) 所有极性元件严禁方向反；
- 8) 不接受虚焊，空焊，焊锡短路；
- 9) 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；
- 10) 手工操作要做防静电处理；
- 11) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；
- 12) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件；

| | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|
| 编制 | | 审核 | | 批准 | |
| 日期 | | 日期 | | 日期 | |